

TED オリジナル(inrevium) 製品信頼性試験データ

対象製品 TE7760PF (ジェイデバイス福岡工場 製造)
パッケージ Plastic LQFP-144 Package(Cu wire)

評価デバイス Device Type	: Test Chip
パッケージ Package Type	: Plastic LQFP-256 Package(Cu wire)

評価項目 Test Item	試験条件 Test Condition	評価数 Sample Size	試験時間 Test Time	不良数 Fail
高温保存試験 High Temperature Storage	150 °C	77 (c)	1000h	0
温度サイクル Temperature Cycling	-65°C~150°C	77 (c)	500cyc	0
パイアス無高加速ストレス試験 uHAST	130°C, 85%RH: 2.33E5 Pa	77 (c)	96h	0

(c) Pre-condition: Baking (125°C, 24h) +Moisture Absorption (30°C/70%RH, 120h) +IR 260°C Max.
+Moisture Absorption (30°C/70%RH, 96h) +IR 260°C Max.

備考 :

本信頼性試験データは、対象製品 (Plastic LQFP-144) と同一工程にて製造した、代表パッケージによる試験結果です。対象製品の信頼性データとして適用されます。